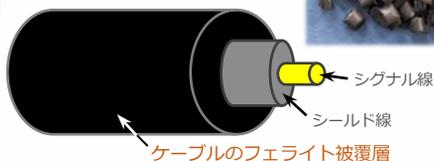


## 軟磁性モールド材料

# 押出成形用 EMCコンパウンド



### 概要

押出成形用EMCコンパウンドは、戸田工業のソフトフェライト粉末や軟磁性メタル粉末をPVCやSEBS樹脂と混合させた軟磁性モールド材で、優れた磁気特性と押出成形性を両立しています。ケーブル被覆層にお使いいただくことで、インピーダンス付与によるノイズ抑制効果が得られます。

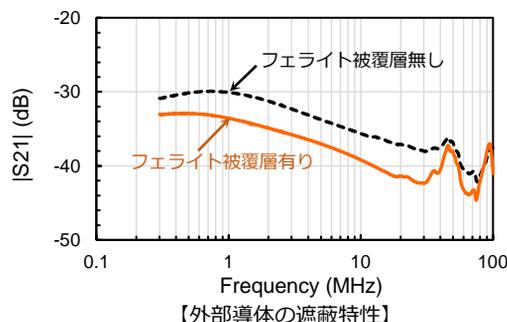
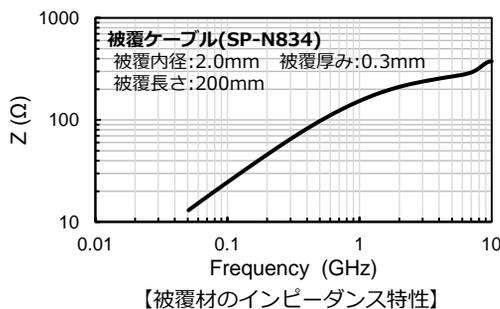
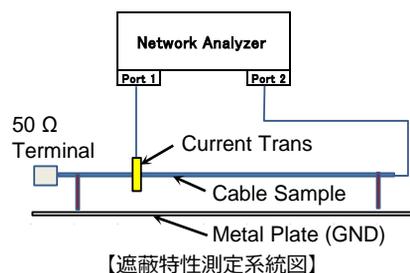
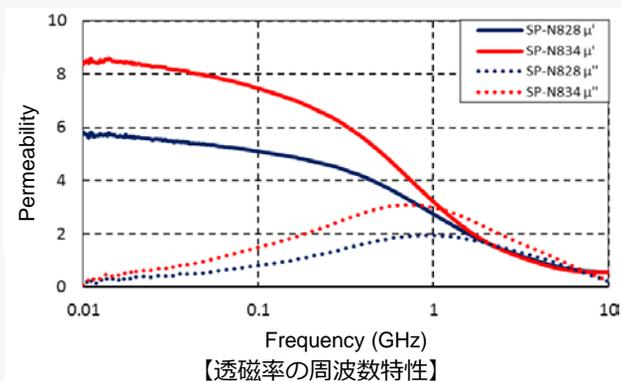
### 特徴

- 1 高透磁率**  
磁性材料を高充填することで優れた透磁率特性を有しています。
- 2 優れた押出成形性**  
樹脂複合化に適した特性を有する磁性粉末を使用しており、成形性に優れています。

### 製品情報

【代表製品の特性】

品名	SP-N834	SP-N828
材質	Ni-Znフェライト/SEBS	Ni-Znフェライト/SEBS
成形密度 (g/cm <sup>3</sup> )	3.4	2.8
流動性MFR (g/10min) [190℃/10kgf]	70	70
$\mu'$ at 100MHz	7.3	5.0
$\mu''$ at 100MHz	2.0	1.0
$\mu'$ at 600MHz	4.5	3.5
$\mu''$ at 600MHz	3.5	1.9
抵抗 ( $\Omega$ )	10 <sup>6</sup>	10 <sup>6</sup>
環境対応	RoHS指令対応 ハロゲンフリー	RoHS指令対応 ハロゲンフリー



### 用途

- ノイズ抑制機能を付与したケーブル被覆材
- ノイズ抑制シート

**戸田工業株式会社**

TODA KOGYO CORP.

東京オフィス

〒108-0014 東京都港区芝5丁目13-15 芝三田森ビル6階  
<https://www.todakogyo.co.jp/>

【お問い合わせ先】 TEL. 03-5439-6040 webmaster@todakogyo.co.jp

本資料に記載したデータは保証値ではありません。また記載内容については、改良などの事由により予告なく変更する場合があります。  
 ©TODA KOGYO CORP. 2021. All rights reserved.

